



2015年3月期 第2四半期 決算説明会資料

2014年11月12日（大阪）

2014年11月13日（東京）

石原ケミカル株式会社

（東証二部 4462）

目次

(代表取締役社長 時澤 元一)

1. 2015年3月期 第2四半期決算の概要
2. 2015年3月期 (通期)の業績予想
3. 株主還元・内部留保の考え方
4. 経営の基本方針

《参考資料》

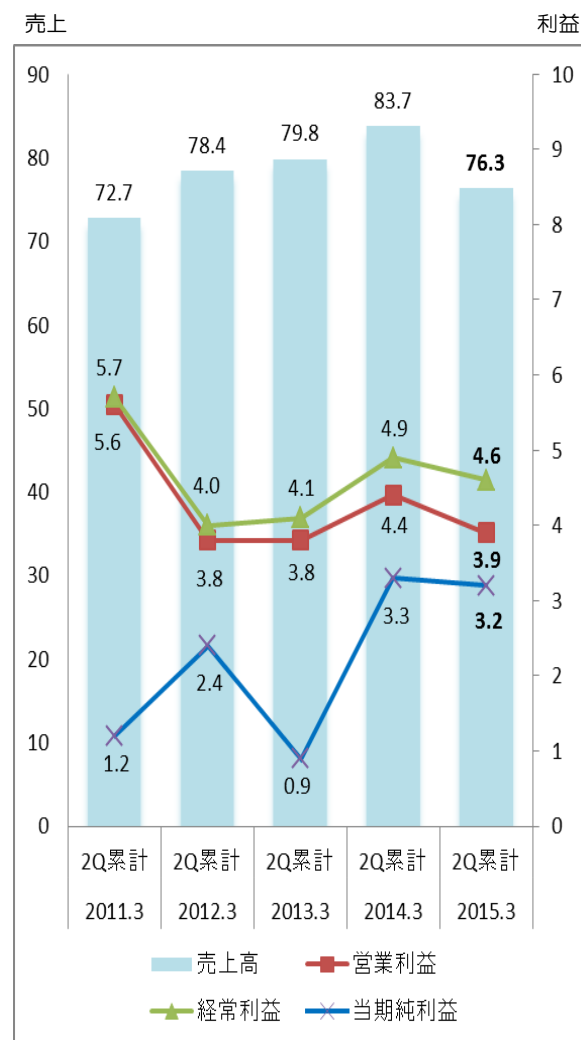
- 技術動向
- 2015年3月期 第2四半期決算短信
- 展示会出展のご報告

本資料のうち、業績予想等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき算出しており、判断や仮定に内在する不確実性および今後の事業運営や内外の状況変化により、実際の業績等が予想値と大きく異なる可能性があります。

2015年3月期 第2四半期決算の概要

	(単位:億円)								
	2015年3月期2Q累計		前年同期		前年		2015年3月期2Q累計		
	実績	構成比	実績	構成比	同期比	増減額	公表値*	構成比	公表値比
売上高	76.3	100%	83.7	100.0%	91.2%	△ 7.4	82.8	100.0%	92.2%
売上原価	55.7	73.0%	62.3	74.4%	89.4%	△ 6.6			
販管費	16.6	21.8%	16.9	20.2%	98.2%	△ 0.3			
営業利益	3.9	5.2%	4.4	5.4%	89.4%	△ 0.5	5.6	6.8%	70.7%
経常利益	4.6	6.0%	4.9	5.9%	94.2%	△ 0.3	6.0	7.2%	77.9%
当期純利益	3.2	4.2%	3.3	3.9%	99.0%	△ 0.1	4.1	5.0%	79.8%
							* 2014年5月公表		

- **売上高**：自動車用化学製品等セグメントが伸びたものの、他のセグメントが前年同期を下回り△8.8%の減収
- **営業利益**：利益率の改善及び販管費の節減を行うも、△10.6%の減益
- **経常利益**：営業外収益（為替差益等）により△5.8%の減益
- 設備投資：188百万円 減価償却費：185百万円 研究開発費：460百万円



セグメント別の営業の状況

セグメント	(単位: 億円)				
	2015年3月期2Q累計		前年同期		前年 同期比
	実績	構成比	実績	構成比	
金属表面処理剤及び機器等	42.1	55.2%	46.4	55.4%	90.6%
電子材料	3.8	5.0%	4.1	4.9%	94.7%
自動車用化学製品等	11.2	14.7%	10.8	12.9%	103.3%
工業薬品	19.1	25.1%	22.2	26.8%	85.8%
合計	76.3	100.0%	83.7	100.0%	91.2%

金属表面処理剤及び機器等

- ・電子部品用めっき液：一般電子部品用めっき液は国内、海外市場とも低調に推移、先端電子部品用ウエハーバンプめっき液は台湾を中心に堅調に推移したが、韓国大口ユーザーの生産減の影響により前年同期を下回る。
- ・管理装置及び試薬：海外市場を中心に堅調に推移し、前年同期を上回る。

電子材料

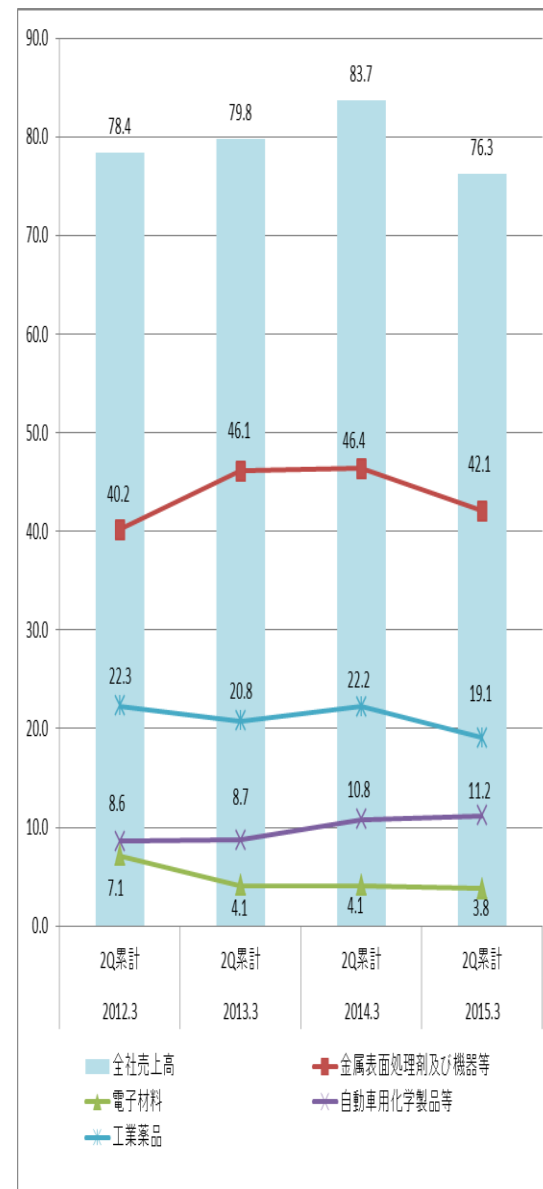
- ・ニッケル超微粉：ユーザーの生産状況は上向いてきたが、前年同期の水準までには達せず。
- ・機能材料加工品：大口ユーザーを中心に好調に推移し、前年同期を上回る。

自動車用化学製品等

引き続きエアコン洗浄剤が好調に推移。

工業薬品

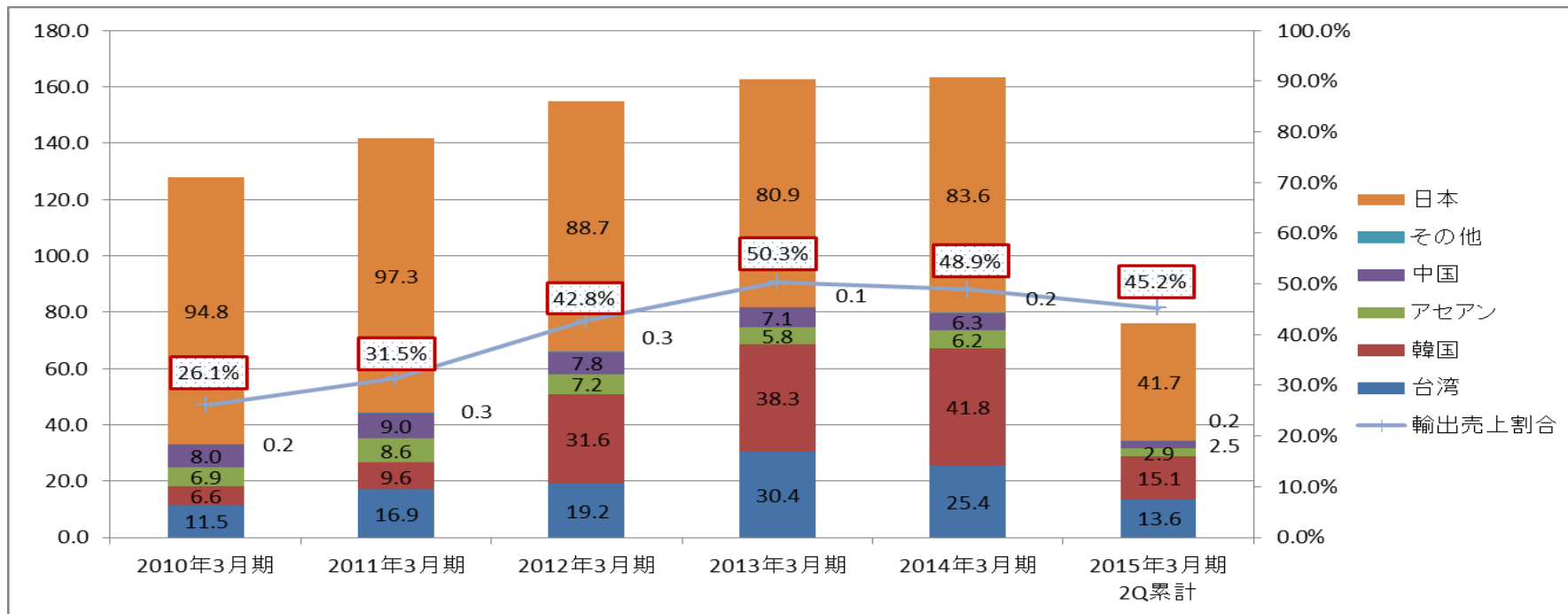
高級鋼板向け特殊薬剤は、メーカー使用量削減により需要が伸びず。



地域別販売の状況

輸出売上高推移

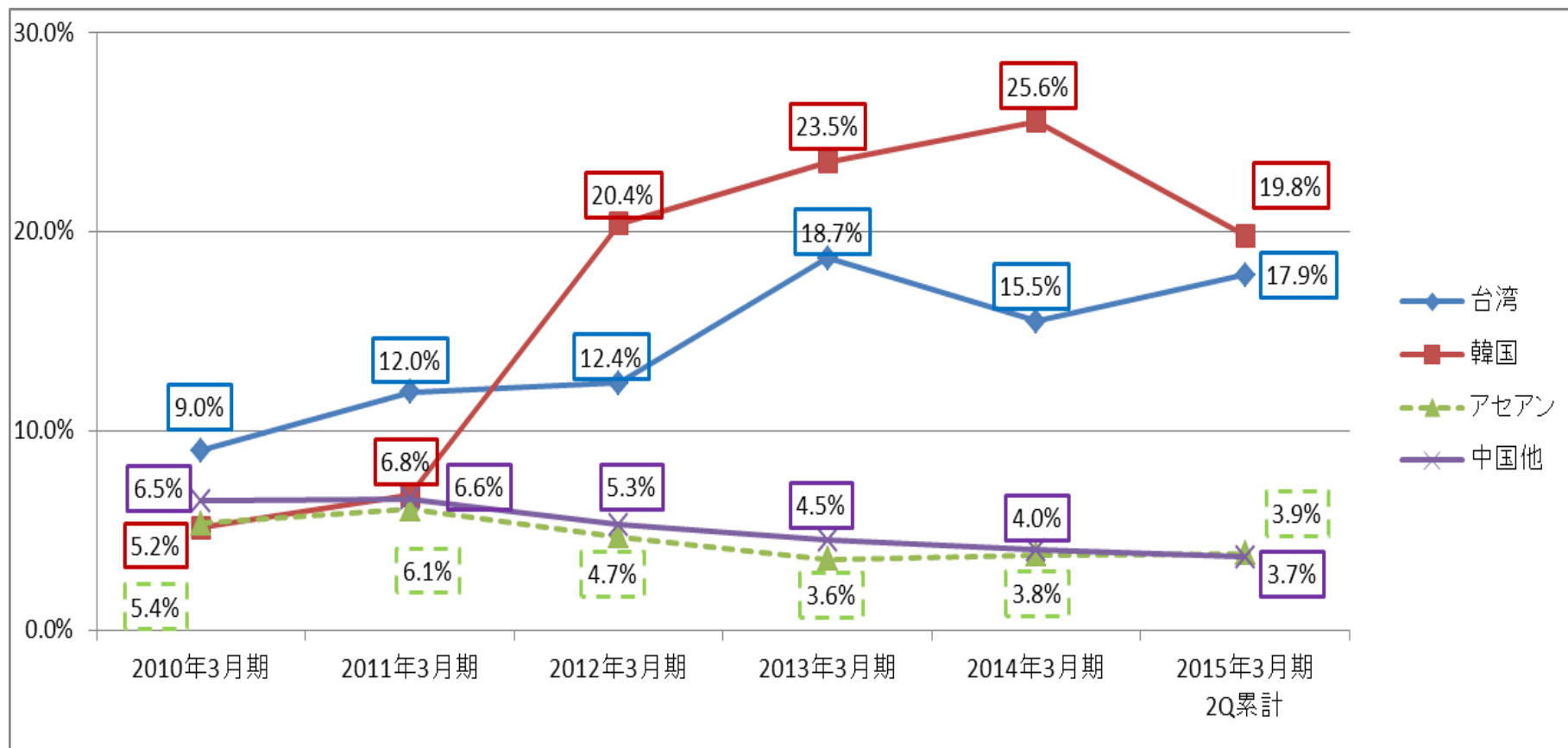
(単位:億円)



地域別売上高	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期 2Q累計
台湾	11.5	16.9	19.2	30.4	25.4	13.6
韓国	6.6	9.6	31.6	38.3	41.8	15.1
アセアン	6.9	8.6	7.2	5.8	6.2	2.9
中国	8.0	9.0	7.8	7.1	6.3	2.5
その他	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
輸出売上計	33.4	44.6	66.4	81.9	80.0	34.5
日本	94.8	97.3	88.7	80.9	83.6	41.7
売上総計	128.2	142.0	155.2	162.8	163.7	76.3

地域別販売の状況

地域別売上構成比の推移



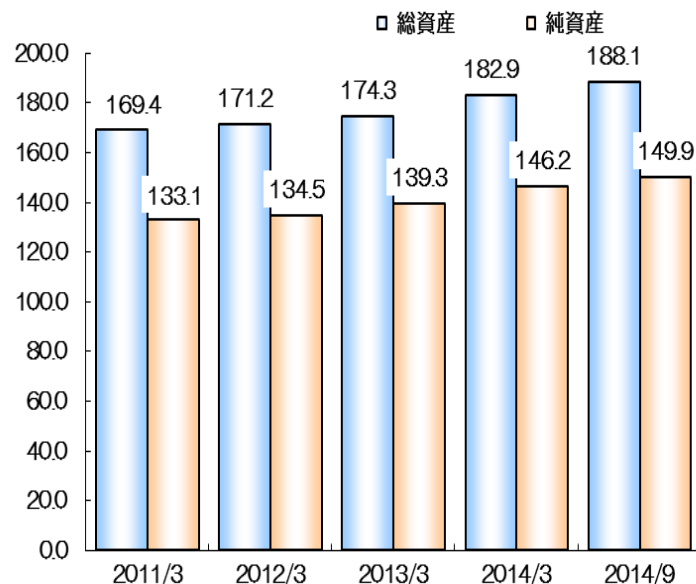
11,957千\$	15,001千\$	12,860千\$	11,160千\$	10,545千\$	4,265千\$	内外貨建売上高
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------

	2014年3月	2014年9月
1USD(計画)	82.00	100.00
1USD(実績)	100.40	103.00

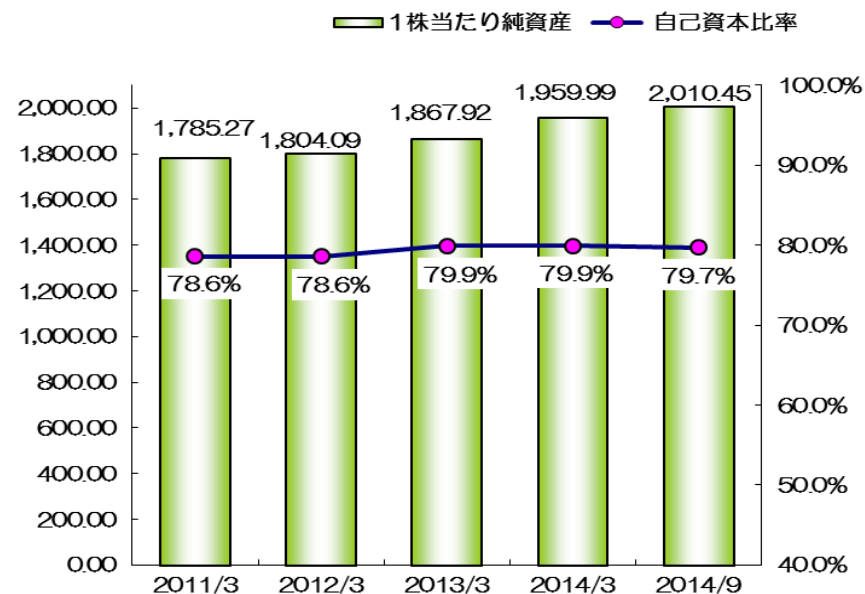
総資産・純資産・1株当たり純資産・自己資本比率の推移

主要経営指標推移		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2014/9
総資産【Total Assets】	(百万円)	16,947	17,122	17,430	18,292	18,812
純資産【Shareholders Equity】	(百万円)	13,318	13,458	13,934	14,621	14,998
1株当たり純資産【BPS】	(円)	1,785.27	1,804.09	1,867.92	1,959.99	2,010.45
自己資本比率【Equity Ratio】	(%)	78.6%	78.6%	79.9%	79.9%	79.7%
自己資本利益率【Return on Equity】	(%)	3.5%	2.8%	2.7%	4.7%	-
一株当たり配当額	(円)	35.00	30.00	30.00	30.00	15.00
内 中 間 配 当	(円)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

(億円)



(円)



2015年3月期の業績予想

(2014年4月1日～2015年3月31日)

(単位:億円)										
	2015年3月期					前年同期			年間 増減率	年間 増減額
	1Q会計期間	2Q会計期間	上期	下期	年間	上期	下期	年間		
	実績	実績	実績	予想	予想	実績	実績	実績		
売上高	36.0	40.3	76.3	90.7	167.0	83.7	80.0	163.7	102.0%	3.3
営業利益	1.0	2.9	3.9	7.2	11.1	4.4	3.8	8.2	135.4%	2.9
経常利益	1.4	3.2	4.6	7.2	11.8	4.9	5.0	9.9	119.2%	1.9
当期純利益	1.0	2.2	3.2	4.9	8.1	3.3	3.3	6.6	122.7%	1.5
1株当たり当期純利益			43.88円		108.58円	44.31円		89.64円		
1株当たり配当額			15.00円		30.00円	15.00円		30.00円		

・設備投資計画:755百万円 減価償却費計画449百万円 研究開発費計画1,030百万円

・計画為替レート 1USD=100.00円

株主還元・内部留保の考え方

平成27年3月期の配当予定

安定配当を基本としつつも、業績、経営環境、財務状況を勘案し、中間配当15円、期末配当15円の年間配当金30円を予定。

株主還元の基本方針

業績に裏付けられた安定的で継続的な配当を行うことを基本としつつ、業績に応じた増配を検討するなど弾力的な還元策をはかっていく方針であります。配当に加えて自己株式取得も機動的に組み合わせて行うことにより、実質的な株主還元の一層の強化をはかります。

内 部 留 保

健全な経営基盤を維持するため内部留保の充実をはかるとともに、内部留保資金の活用については、研究開発や新事業、新技術開発など将来の企業価値を高めるための投資に優先して充当してまいります。

経営の基本方針

- (1)当社は自己開発・商品開発・市場開発の「三つの開発」を企業理念とし、ニッチ市場といわれる事業分野で高い市場占有率を維持し、基幹となる3つの分野で事業をバランスよく展開し、各々の収益力を高め、総体として会社の業績の伸長をはかる。
- (2)このような事業活動を通じて常に新しいニーズの創造・発掘に取り組み、会社の発展を通じて、株主・取引先・従業員など関係各位の信頼と期待に応え、社会に貢献していく。

企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に努める。

全てのステークホルダーの満足度向上

- ▶ この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点において当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
- ▶ 当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。本資料記載の業績見通しのみ全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願い致します。
- ▶ なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送等をおこなわれぬようお願い致します。

ありがとうございました

2014年11月

石原ケミカル株式会社

(東証二部 4462)

URL: <http://www.unicon.co.jp>

《参考資料》

- 技術動向
- 平成27年3月期 第2四半期決算短信
- 展示会出展のご報告

《技術動向》 (代表取締役社長 時澤 元一)

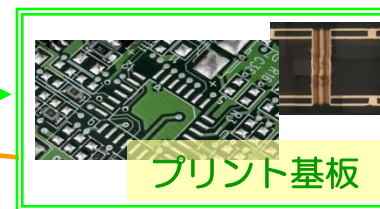
金属表面処理剤（めっき液）の用途：

電子部品や半導体を電気回路に接続（搭載）する目的に使用

電子製品

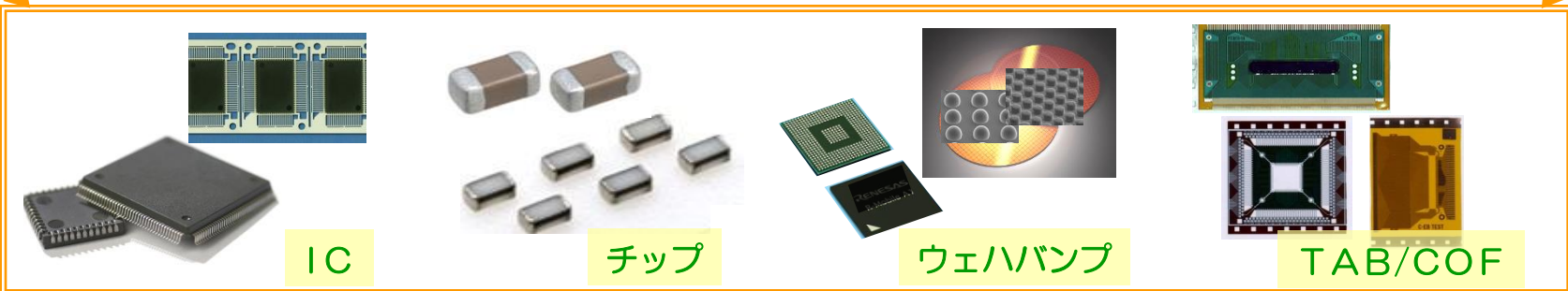
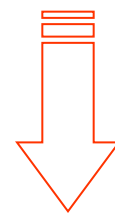


基板



銅めっき液

電子部品



めっき液

鉛フリーめっき液

中性スズめっき液

バンプ用めっき液

無電解スズめっき液

《新技術・新製品開発の状況》

次世代電子回路基板への適用が期待される

導電性銅ナノインクを開発

銅ナノインクに注目して研究開発した理由は・・・

- ◎ 銅は導電性がよく配線材料に適している
- ◎ 銅はマイグレーションしにくい
(電界の影響で金属成分が非金属媒体の上や中を横切って移動する現象)
- ◎ 銅は資源的に豊富である など

さらに

インクジェット印刷法による
回路形成を実用化すれば

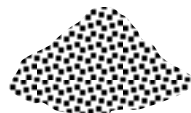
プロセスの簡略化による
コストダウン

少量多品種への対応

環境にやさしい
(廃液・廃棄物が少ない)

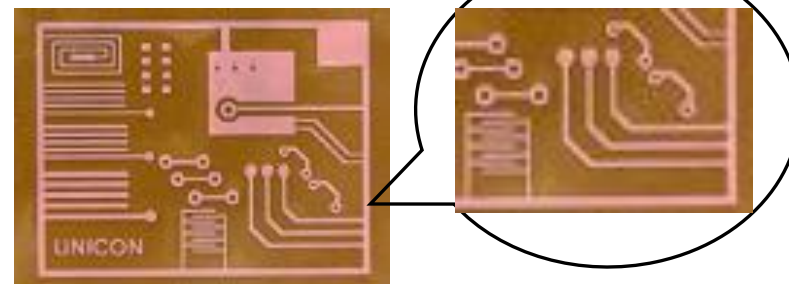
石原ケミカルでは銅ナノ粉からインク化まで
自社で一貫して開発を進めています

銅原料



銅ナノ粉

銅ナノインク



▲ポリイミド基板に
導電性銅ナノインクを用いて形成した回路

様々なアプリケーションにおいて
配線や電極として利用が期待されています

想定されるアプリケーション



ディスプレイ



太陽電池

LED

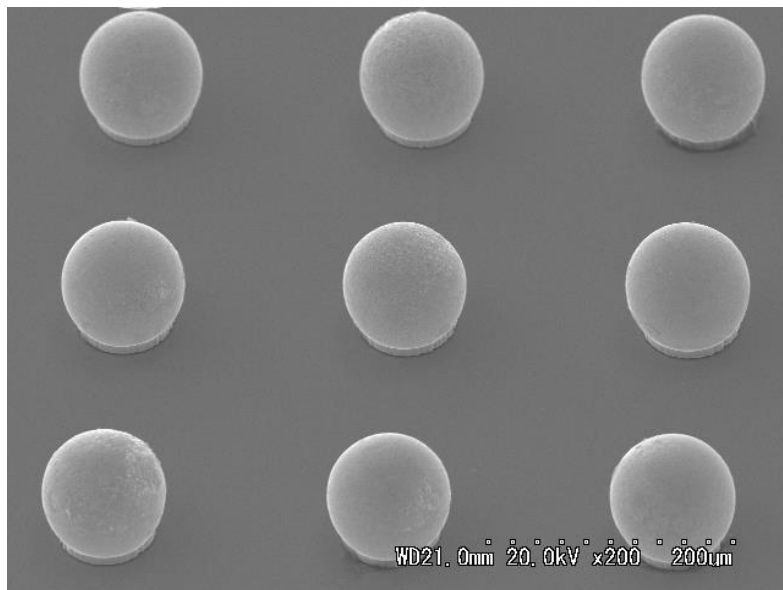


FPC

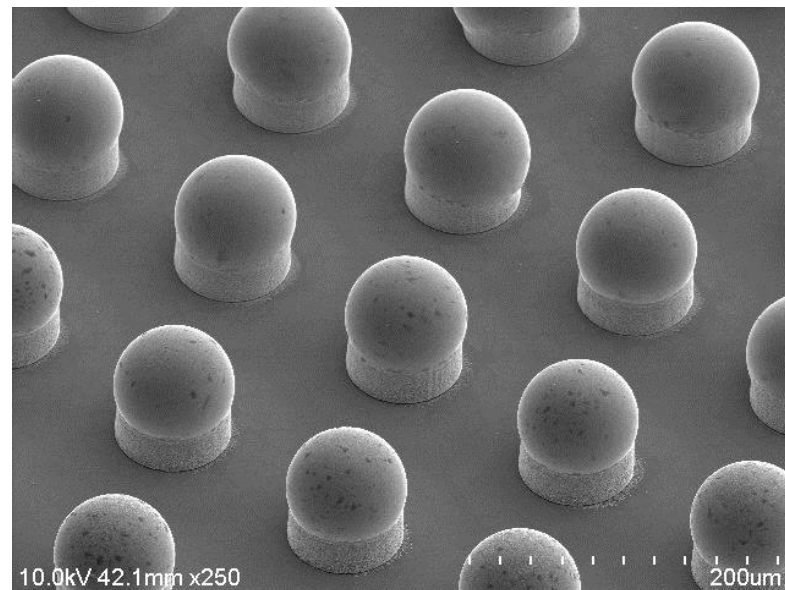


RFID

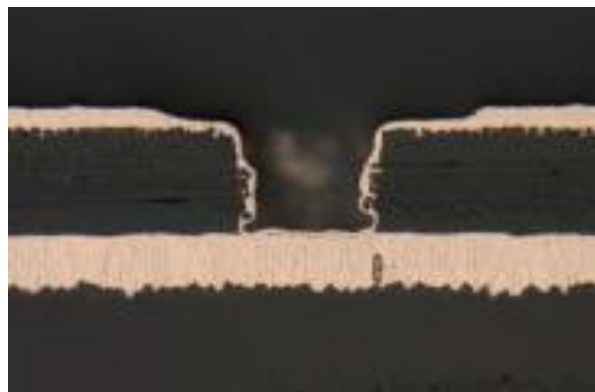
通常バンプ



Cuピラーバンプ



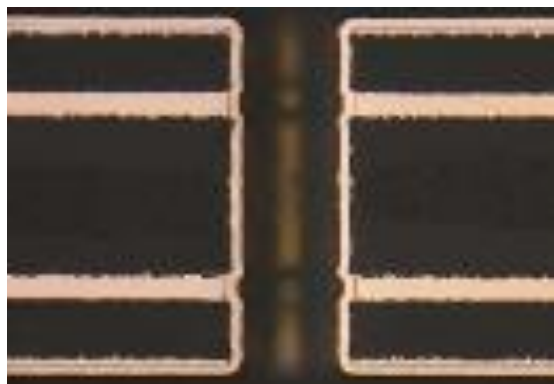
プリント基板



基板Via部分フィリング前



基板Via部分フィリング後



基板スルホール部分

展示会出展のご報告

海外

SEMICON China 2014



上海の会場にブースを開設 2014/3

第15回 半導体パッケージング技術展



東京ビッグサイト 2014/1

国内

JPCA SHOW2014



東京ビッグサイト 2014/6

SURTECH2014 表面技術要素展



東京ビッグサイト 2014/1